

Chips Act 2.0

Handlungsempfehlungen der Deutschen Industrie

24. September 2026

Executive Summary

Der Chips Act 2.0 sollte als Instrument zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Anwenderindustrien verstanden werden. Dafür reicht der Ausbau von Halbleiterkapazitäten allein nicht aus. Entscheidend ist, industrielle Nachfrage, private Investitionen, schnelle Umsetzung und marktwirtschaftliche Resilienz wirksam miteinander zu verbinden. Aus Sicht der deutschen Industrie sind fünf Punkte zentral: ein rechtssicherer Zugang zu ESTI-, Strategic-Project- und Plattforminstrumenten auch für EU-ansässige Produktionsstandorte mit vertrauenswürdigen Partnerlandstrukturen; ein ausdrücklicher Fokus auf Mature und Specialty Nodes, Advanced Packaging sowie Physical AI; eine verlässliche Finanzierung über den European Competitiveness Fund; eine strukturierte Industriebeteiligung bei Priorisierung, Pilotlinien, Demand Accelerators und Projektbewertung; sowie verhältnismäßige Monitoring- und Krisenpflichten, die keine neuen Investitionshemmnisse schaffen.

Inhaltsverzeichnis

Chapter I – General provisions	3
Chapter II – Chips for Europe Initiative 2.0	4
Chapter III – Security of supply and demand	7
Chapter IV – Monitoring and crisis response	10
Chapter V – Governance.....	11
What’s missing?.....	12
Impressum	15

Chapter I – General provisions

Der in Chapter I skizzierte strategische Rahmen des Chips Act 2.0 stellt gegenüber dem Chips Act 1.0 eine wichtige Weiterentwicklung dar. Wettbewerbsfähigkeit, Nachfrage, Innovationskraft, technologische Souveränität und wirtschaftliche Prosperität werden nun zu Recht als zentrale Zielgrößen definiert. Im Kontext des „Technology Sovereignty Package“ markiert dies einen wichtigen Schritt hin zu einer aktiveren europäischen Industrie- und Standortpolitik für das Halbleiterökosystem. Damit dieser Anspruch nicht durch andere politische Vorhaben konterkariert wird, sollten neue und bestehende EU-Regulierungen systematischen Wettbewerbsprüfungen unterzogen werden, die ihre kumulativen Auswirkungen auf die Halbleiterindustrie frühzeitig bewerten.

Der Ökosystem-Ansatz ist die notwendige Neuorientierung für die Überarbeitung des ersten Chips Act: weg von einer primären fördermittel- und kapazitätsgetriebenen Logik, hin zu einer nachhaltigen Verbesserung des gesamten Halbleiterökosystems. Entscheidend ist dabei, die richtigen Prioritäten bei Zukunftstechnologien zu setzen, die Europa in der globalen Wertschöpfungskette unverzichtbar machen können. Diese Prioritätensetzung muss zwingend in enger Kooperation mit der Industrie erfolgen und an konkreten Anwenderbedarfen ausgerichtet werden. Nur so führen geförderte Projekte zu marktfähigen Produkten, tragfähigen Geschäftsmodellen und langfristig wettbewerbsfähiger industrieller Wertschöpfung.

Die Nachfrageperspektive des Chips Act 2.0 sollte nicht ausschließlich auf den europäischen Binnenmarkt ausgerichtet werden. Europäische Schlüsselindustrien agieren erfolgreich auf globalen Märkten und benötigen Zugang zu wettbewerbsfähigen Halbleitertechnologien zur Sicherung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Der Chips Act 2.0 sollte deshalb neben europäischen Bedarfen auch die globale Wettbewerbs- und Exportfähigkeit europäischer Anwenderindustrien berücksichtigen.

Besonders zu begrüßen ist die breite Definition der Halbleiterwertschöpfungskette sowie die Erweiterung des First-of-a-kind-Ansatzes auf Ausrüstung, Materialien, Schlüsselkomponenten, Elektronikfertigung, Integration und herstellungszentriertes Chipdesign. Dies entspricht der industriellen Realität und eröffnet bessere Chancen, europäische Stärken in Zulieferindustrie, Leistungshalbleitern, Advanced Packaging, Photonik, Chipdesign und industrieller Anwendung gezielt zu stärken. Zur gesamten Wertschöpfungskette gehören allerdings langfristig auch Kreislaufwirtschaftsansätze, die Wiederverwendung und Rückgewinnung kritischer Materialien sowie die Stärkung europäischer Kompetenzen im Recycling elektronischer Komponenten. Diese zu berücksichtigen kann einen zusätzlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit und Rohstoffresilienz leisten. Die deutsche Industrie empfiehlt in diesem Zusammenhang eine stärkere Abstimmung mit anderen EU-Regulierungen, um kollidierende Anforderungen zu vermeiden und eine stärkere Berücksichtigung der besonderen Reinheitsanforderungen der Halbleiterfertigung zu gewährleisten.

Die Definition von „Domestic undertaking“ ist ein zentraler Rechts- und Investitionshebel und muss deutlicher präzisiert werden. Zwar ist es richtig, vertrauenswürdige Partnerländer einzubeziehen. Entscheidend sind jedoch klare operative Kriterien, etwa zu Kontrolle, IP-Schutz, wirtschaftlicher Sicherheit, Standortbindung in Europa und rechtlicher Durchsetzbarkeit von Zusagen. Ohne solche Kriterien drohen Rechtsunsicherheit, uneinheitliche Anwendung und vermeidbare Investitionszurückhaltung.

Chapter II – Chips for Europe Initiative 2.0

Chapter II setzt an entscheidenden Schwachstellen des bisherigen Chips Act an: dem Transfer von Forschung in industrielle Anwendung, der Stärkung von Design- und Pilotinfrastrukturen, der gezielten Förderung von Quantum-, Photonik- und Edge-AI-relevanten Technologien sowie der besseren Einbindung von Anwenderindustrien über Demand Accelerators, Demand Forum und Innovation Procurement.

Damit Chapter II seine Wirkung entfalten kann, müssen jedoch fünf Voraussetzungen erfüllt werden:

- Erstens braucht es eine klare Priorisierung auf europäische Stärkefelder sowie eine „No Fragmentation Rule“, um sicherzustellen, dass Mittel auf Projekte mit ausreichender Größenordnung, substanzieller industrieller Kofinanzierung und klarer Skalierungsperspektive konzentriert werden.
- Zweitens müssen Pilotlinien und Kompetenzzentren konsequent an industriellen Bedarfen ausgerichtet und für Start-ups, KMU und Anwenderindustrien niedrigschwellig zugänglich sein.
- Drittens braucht es rechtssichere Zugangskriterien für EU-ansässige Unternehmen und gleichgestellte Partnerlandunternehmen.
- Viertens müssen Demand Accelerators und Demand Forum durch eine starke, arbeitsfähige und ausreichend finanzierte Industrial Alliance umgesetzt werden – inklusive einer starken Einbindung der Industrie in die Koordination und Entscheidungsmechanismen. Dies sollte durch ein industriell besetztes Steering Committee mit Mitentscheidungs- und Stimmrechten im European Semiconductor Board institutionell abgesichert werden.
- Fünftens braucht die Initiative eine verlässliche Finanzierungsbasis über 2027 hinaus, insbesondere durch eine langfristige Anschlussfinanzierung im Rahmen des **European Competitiveness Fund**.

Pilotlinien

Eine wichtige Rolle beim **Transfer von der Wissenschaft in die industrielle Anwendung** spielen im Chips Act 2.0 **Pilotlinien** (Art. 4). Sie bieten Potenzial beim Schaffen von Innovationen und können somit die Innovationsgeschwindigkeit in Europa nachhaltig steigern, was von großer Bedeutung im internationalen Wettbewerb ist, in dem Europa nach wie vor deutlich zurückliegt.

Drei Jahre nach der ersten Ankündigung der Pilotlinien im Chips Act 1.0 sind diese noch immer nicht vollständig funktionsfähig. Um ihre Wirkung als Transferinstrument zu erhöhen, sollte für jede Pilotlinie ein verpflichtender Industriebeirat mit klaren Mitwirkungsrechten eingerichtet werden, der Serviceportfolio, industriefreundlichen Zugang und Vermarktung begleitet. Industrielle Bedarfe müssen stärker darüber entscheiden, welche Pilotlinien künftig etabliert und gefördert werden. Ergänzend sollten konkrete KPIs eingeführt werden, um Fortschritt, Auslastung, Industriezugang und Transfererfolge messbar zu machen. Für Start-ups und KMU wäre ein zentraler Zugang zu Pilotlinien besonders wichtig. Eine zentrale Zugangs- und Informationsinfrastruktur könnte Transparenz erhöhen, Antragsprozesse vereinfachen und die Nutzung bestehender Pilotlinien beschleunigen. Dadurch ließen sich Umsetzungsgeschwindigkeit und Effizienz deutlich verbessern. Ergänzend sollten „Lab-to-Fab Accelerators“ in einem eigenen Artikel formalisiert und regelmäßig genutzt werden, um Technologien aus Pilotlinien schneller in industrielle Fabriken und die Volumenfertigung zu überführen. Der Kommissionsvorschlag

enthält keine ausreichenden Kriterien für die Standortwahl der im Chips Act 2.0 angekündigten Pilotlinien. Aus Sicht der deutschen Industrie sollte bei der Auswahl und Weiterentwicklung von Pilotlinien berücksichtigt werden, wo bereits industrielle Anwender, Forschungsinfrastrukturen, Fachkräftebasis und Skalierungspotenziale vorhanden sind. Bestehende Cluster sollten weiter gestärkt werden, um bestehende Infrastruktur nutzen zu können und durch kurze Wege einen Industrietransfer zu erleichtern. Darüber hinaus sollte besonderes Augenmerk auf die übergeordnete Förderung technologischer Exzellenz gelegt werden.

Zudem sollte ein verstärkter Fokus auf Pilotlinien nicht dazu führen, dass finanzielle Mittel aus etablierten Instrumenten wie dem Electronic Components and Systems (ECS) Pillar im Chips Joint Undertaking umgeschichtet werden. Der ECS hat sich als zentrales Transferinstrument zwischen Wissenschaft und Industrie bewährt und repräsentiert Industrie, Mitgliedstaaten und Europäische Kommission ausgewogen. Im Rahmen des ECS waren rund 1,8 Mrd. EUR für kollaborative Projekte mit Industrie und Wissenschaft vorgesehen; davon wurden 500 Mio. EUR in die Finanzierung der Chips for Europe Initiative umgeschichtet. Solange Pilotlinien ihre Wirksamkeit als zentrales Transferinstrument noch nicht unter Beweis gestellt haben, ist eine Umschichtung zulasten eines etablierten und funktionierenden Instruments industriepolitisch nicht überzeugend. Für Transferaktivitäten an Pilotlinien sollte vielmehr ein eigenes Budget vorgesehen werden, bei dem mindestens zwei Drittel auf den industriellen Anteil und höchstens ein Drittel auf die Pilotlinie entfallen.

Strategische Fokussierung auf europäische Stärken und Schlüsseltechnologien

Die Industriepolitische Neuausrichtung durch die Fokussierung auf strategisch relevante Bereiche begrüßt die deutsche Industrie ausdrücklich. Im globalen Investitionswettrennen und den stetigen Fortschritten der industriellen Wettbewerber ist es zwingend erforderlich diese Fokussierungen vorzunehmen, um schon bestehende **europäische Stärken weiter auszubauen** und die **Position der Unverzichtbarkeit in der globalen Wertschöpfungskette** zu stärken. Die bislang gesetzte Priorisierung ist allerdings noch zu breit und unkonkret. Sie sollte durch eine verbindliche Technologie-Roadmap mit einem Zeithorizont von zehn bis zwanzig Jahren, messbaren Meilensteinen und regelmäßigen Überprüfungs- und Auslaufklauseln konkretisiert werden. Priorisierungen müssen kontinuierlich in Einklang mit den industriellen Stärken Europas und Marktentwicklungen gesetzt und bei Bedarf angepasst werden.

Dass die Entwicklung von **cutting- und leading-edge Halbleiter-Technologien** für bestimmte Branchen vorangetrieben werden soll, ist der richtige Weg bei der Berücksichtigung industrieller Bedarfe. Dementsprechend sollte die Industrie immer systematisch in konkrete Zielsetzungen und Priorisierungsprozesse eingebunden werden.

Die Fokussierung auf Edge-Anwendungen, KI-Chips und Quantentechnologien ist ausdrücklich zu begrüßen. Ebenso ist die vorgesehene Stärkung des Chipdesign ein richtiger und notwendiger Schritt. Gleichzeitig ist mit **Physical AI** ein zentrales Zukunftsfeld bislang nicht ausreichend berücksichtigt. Angesichts der zunehmenden Verschmelzung von Künstlicher Intelligenz mit der physischen Welt, insbesondere in den Bereichen Robotik, industrielle Automatisierung, autonome Systeme und intelligente Fertigung, sollte Physical AI explizit als **strategisches Handlungsfeld** in den Chips Act 2.0 aufgenommen werden. Ziel sollte dabei nicht die Förderung einzelner Branchen oder konkreter Use Cases sein, sondern der Aufbau einer leistungsfähigen europäischen Basis für Compute-, KI- und Halbleiterplattformen, die in unterschiedlichsten industriellen Anwendungen genutzt werden können. Gerade diese sektorübergreifende Verwendbarkeit schafft die notwendigen Skaleneffekte und stärkt Europas technologische Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig.

Mit der Digitalisierung kritischer Infrastrukturen und vernetzter Systeme gewinnen zudem **Hardware Security, Vertrauenswürdigkeit und Integrität von Halbleitern** zunehmend an Bedeutung. Europa sollte daher **Trusted Semiconductors, Hardware Root of Trust, Security-by-Design-Ansätze** und sicherheitskritische Mikroelektronik als strategische Technologiefelder des Chips Act 2.0 verankern.

Die operativen Ziele sollten im Arbeitsprogramm des Chips Joint Undertaking auf klar definierte europäische Stärkefelder konzentriert werden. Die Auswahl und Priorisierung müssen transparent und in enger Abstimmung und regelmäßiger Rückkopplung mit der Industrie hinsichtlich des Marktpotenzials, wirtschaftlicher Tragfähigkeit, Resilienzbeitrag und industrieller Nachfrage erfolgen. Aus Industriesicht zählen zu den Stärkefeldern und den Bereichen mit erheblichem Potenzial aktuell insbesondere Edge AI und Physical AI, Leistungshalbleiter, Sensorik und Equipment-Herstellung eingeschlossen der Zulieferkomponenten, Metrologie und industrielle Spezialchips sowie sicherheitskritische Halbleiterlösungen. Europa sollte dabei insbesondere auf jene Technologiefelder setzen, in denen bereits heute weltweit führende Positionen bestehen oder realistische Chancen auf eine strategische Führungsrolle vorhanden sind.

Zusätzlich bestehen erhebliche Wachstumspotenziale in Zukunftsfeldern wie Photonik und Quantenchips und auch beim Advanced Packaging, wo der Übergang in die industrielle Serienfertigung entscheidend zur Stärkung europäischer Wertschöpfungsketten beitragen kann. Nachhaltige Halbleiterfertigung sollte dabei, als Querschnittsthema berücksichtigt werden. Dass auch das Chipdesign durch verschiedene Ansätze im Chips Act 2.0, aber auch auf nationaler Ebene mit der Hightech Agenda gezielt gefördert wird, ist richtig, um Europas Designkompetenz auszubauen.

Europäische Kooperationsinstrumente

Für die Umsetzung der gesetzten Ziele, braucht es europäische Kooperationsinstrumente. Mit dem Netzwerk für Kompetenzzentren und dem Demand Forum schafft der Chips Act 2.0 potenziell eine solide Grundlage. Die Industrial Alliance braucht klare Zuständigkeiten, ausreichende Ressourcen und eine starke Rolle bei Demand Accelerators, Demand Forum und der Rückkopplung industrieller Bedarfe in Grand Challenges, Pilotlinien und Designinfrastrukturen.

Grand Challenges

Die Einführung von **Grand Challenges** nach Artikel 7 ist zu begrüßen, da sie die Entwicklung strategisch relevanter Technologien durch sektorübergreifende F&E-Kooperationen beschleunigen kann. Gleichzeitig sollten diese Initiativen eng mit den Förderinstrumenten des künftigen **European Competitiveness Fund** abgestimmt und angebunden werden. Entscheidend ist ein durchgängiger Förderansatz, der Unternehmen aller Größenklassen und Forschungseinrichtungen von der Forschung über Demonstrationsprojekte bis zur industriellen Skalierung begleitet und so den Transfer innovativer Technologien in den Markt erleichtert.

Demand Accelerators

Die europäische Nachfrage nach Halbleiter-Technologien ist stark fragmentiert. Das Ziel der Kommission, diese Nachfrage gezielt zu bündeln und europäische Technologien zu stärken, ist grundsätzlich ein wichtiger Ansatz, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Halbleiterwirtschaft zu verbessern und Abhängigkeiten von Drittstaaten zu reduzieren. Die dafür vorgesehenen Demand Accelerators begrüßt die deutsche Industrie, deren genaue Ausgestaltung sollte allerdings im weiteren Legislativprozess konkretisiert werden. Zudem muss sichergestellt werden, dass diese mit bestehenden und

geplanten EU-Rechtsakten, insbesondere dem Public Procurement Act, Cybersecurity Act 2 und dem Industrial Accelerator Act, im Einklang stehen..

Die Demand Accelerators sollten gemeinsame **technische Roadmaps, Co-Design-Projekte und industrielle Abnahmeperspektiven** in enger Abstimmung mit der Industrie entwickeln. Vorgaben und Berichtspflichten zu Beschaffung, Diversifizierung und Zweitquellenstrategien bergen kostenbedingte Wettbewerbsrisiken. Stattdessen sollte Europa zentrale Herausforderungen von Anwenderindustrien systematisch adressieren und durch gezielte Maßnahmen Innovation, Wachstum sowie Partnerschaften mit lokalen Technologieanbietern fördern. Außerdem sollte dabei die Einbeziehung von gleichgesinnten internationalen Partnern geprüft werden, sofern diese Versorgungssicherheit, IP-Schutz und wirtschaftliche Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Chapter III – Security of supply and demand

Section 1: Semiconductor Manufacturing Capabilities

Die deutsche Industrie begrüßt, dass der Chips Act 2.0 **European Semiconductor Technology Initiatives (ESTI)** und **Strategic Projects** als Projekte von öffentlichem Interesse einordnet und damit eine stärkere politische, administrative und finanzielle Unterstützung strategisch relevanter Halbleiterprojekte ermöglicht. Dies ist ein wichtiges Signal für Investitionen in Europa. Damit dieses Instrument tatsächlich investitionswirksam wird, müssen ESTI- und Strategic-Project-Status aber auch für EU-ansässige Produktions- und Innovationsstandorte mit gleichgesinnten internationalen Eigentümerstrukturen erreichbar bleiben. Eine zu enge Domestic-Undertaking-Definition würde gerade solche Investitionen ausschließen, die Europa für Resilienz, Skalierung und Technologieführerschaft benötigt.

Die Erweiterung des **First-of-a-kind-Ansatzes** folgt den industriellen Bedarfen. Einbezogen werden nun nicht nur klassische Fertigungsanlagen, sondern auch Equipment, Schlüsselkomponenten, Materialien, Elektronikfertigung, Integration und herstellungszentrierte Chipdesign-Aktivitäten. Der Chips Act 2.0 wird damit entlang der gesamten Halbleiterwertschöpfungskette ausgestaltet und bezieht auch Zulieferer, Ausrüstungshersteller, Materialien, Designakteure, Integratoren, Start-ups und KMU ein. Diese Weiterentwicklung wird von der Industrie ausdrücklich unterstützt. Gleichzeitig sollte der Fokus nicht ausschließlich auf Leading-Edge- und KI-Technologien liegen. Für die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Schlüsselindustrien sind auch Mature, Advanced und Specialty Nodes, Leistungshalbleiter, Speichertechnologien sowie weitere industrielle Basistechnologien von zentraler Bedeutung. Der Chips Act 2.0 sollte bestehende strategische Abhängigkeiten entlang des gesamten Technologiespektrums systematisch berücksichtigen und adressieren. Der Anspruch einer technologieoffenen und ausgewogenen Förderung entlang der gesamten Halbleiterwertschöpfungskette sollte sich konsequent auch in den operativen Bestimmungen widerspiegeln. Daher sollte die höchste Prioritätsstufe oder ein gleichwertiger Mechanismus auf Strategic Projects für Mature, Advanced und Specialty Nodes sowie für Advanced Packaging ausgeweitet werden, um eine strukturelle Benachteiligung dieser für die europäische Automobil-, Industrie- und Verteidigungselektronik zentralen Fertigungssegmente zu vermeiden.

Die Einführung von **Strategic Projects** kann ein wirksames Kerninstrument des Chips Act 2.0 werden, um öffentliche und private Investitionen gezielt zu lenken und wichtige europäische Projekte zu fördern. Die Auswahl solcher Projekte sollte jedoch nicht allein anhand politischer oder technologischer Kriterien erfolgen. Neben Resilienz, technologischer Souveränität und Cross-border-Dimension müssen ausdrücklich auch wirtschaftliche Tragfähigkeit, industrielle Nachfrage, Skalierbarkeit, private

Investitionsbereitschaft, Marktpotenzial und der Beitrag zu europäischen Stärkefeldern berücksichtigt werden. Dafür sollten Akteure mit Investoren-, Produktions- und Anwenderperspektive strukturell in die Evaluation eingebunden werden. Strategic Projects sollten zudem nachweisen, dass sie über den gesamten Projektlebenszyklus strukturelle Marktnachfrage adressieren; als Referenz können die Prioritäten der Demand Accelerators und die Erkenntnisse der Industrial Alliance dienen. Die Rolle des Chips JU sollte auf die technologische Bewertung fokussiert bleiben. Für die Benennung von Strategic Projects sollte ein einheitliches, transparentes Verfahren nach Artikel 18 Absatz 2 gelten; Artikel 18 Absatz 3 sollte gestrichen werden. Kritisch zu bewerten sind mögliche Investitionshemmnisse durch zusätzliche Pflichten für ESTIs und Strategic Projects, etwa Teilnahme an der B2B-Plattform, Monitoring-Anforderungen, Informationspflichten für Eigentümer oder potenzielle Verpflichtungen in Krisensituationen. Solche Verpflichtungen können potenzielle Investoren verunsichern, wenn Nutzen, Pflichten und Risiken nicht klar austariert werden. Insbesondere dürfen Plattformzugang und ESTI-Status nicht durch eine Domestic-only-Ausgestaltung widersprüchlich miteinander verknüpft werden; EU-ansässige Produktionsstandorte sollten unter Sicherheitsauflagen teilnehmen können. Adressat sensibler Informationspflichten sollte grundsätzlich die europäische Rechtseinheit beziehungsweise deren gesetzlicher Vertreter sein, nicht mittelbare oder nicht-operative Anteilseigner in Drittstaaten.

Section 2: Permit-Granting Procedures

Gerade im Halbleitersektor sind Planbarkeit und Geschwindigkeit entscheidende Standortfaktoren. Die vorgesehenen beschleunigten Genehmigungsverfahren für European Semiconductor Technology Initiatives und Strategic Projects sind ein positives Signal für die Handlungsfähigkeit des Halbleiterökosystems. Die maximale Dauer von zwölf Monaten ab vollständigem Antrag, die Einrichtung von **One-stop-shops** sowie die Digitalisierung über Single Access Portals und European Business Wallets sind wichtige Schritte zur Verbesserung der Standortattraktivität Europas. Dies sendet ein positives Signal für potenzielle Investitionen.

Dieser Ansatz gilt allerdings vor allem für ESTIs und Strategic Projects. Damit wird nur ein kleiner Ausschnitt relevanter Prozesse erfasst. FOAK-Projekte, die kein Strategic Project sind, sowie IPCEI-Projekte und -Vorhaben sind nicht abgedeckt. Die Verfahrensbeschleunigung sollte auf alle ECA-relevanten Investitions- und Innovationsvorhaben ausgeweitet werden. Dazu gehören außerdem Zulieferprojekte, Ausrüstungsprojekte und wichtige Infrastrukturmaßnahmen.

Die Beschleunigung von Verfahren sollte mit messbarer Vereinfachung, Parallelisierung und Entbürokratisierung einhergehen. Eine bloße Verkürzung formaler Fristen reicht nicht aus und könnte Behörden sowie Unternehmen zusätzlich unter Druck setzen, wenn Verfahren selbst unverändert komplex bleiben. Die Implementation eines One-Stop-Shops ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die Umsetzung praxistauglich erfolgt. In föderalen Mitgliedstaaten wie Deutschland kann eine zentrale Anlaufstelle jedoch schwer umzusetzen sein. Deswegen sollten die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung frühzeitig konsultiert werden. Gleichzeitig sollte der One-Stop-Shop möglichst in bestehende und vorgesehene europäische Förder- und Investitionsportale integriert werden, um Fragmentierung zu vermeiden, Transparenz zu erhöhen und Unternehmen einen einfachen Zugang zu relevanten Programmen, Projekten und Kooperationsinitiativen zu ermöglichen.

Section 3: European Semiconductor Regions of Excellence

Starke Halbleitercluster und -netzwerke sind ein zentraler Vorteil der europäischen Halbleiterindustrie, da sie sowohl Forschung, Industrie, Zulieferer, Fachkräfte und Investoren zusammenführen und kürzere Innovationszyklen ermöglichen. Die Einführung eines **European Semiconductor Region of**

Excellence Labels kann dazu beitragen, bestehende Exzellenzcluster und -netzwerke weiter zu stärken und öffentliche sowie private Investitionen besser auf vorhandene Ökosysteme auszurichten. Das Netzwerk, das daraus entstehen soll, bietet ein großes Potenzial für die weitere Vernetzung wichtiger Standorte in Europa und gleichgesinnten internationalen Partnern. Bei der Umsetzung muss allerdings das Verhältnis zum schon bestehenden ESRA-Netzwerk geklärt werden. Darüber hinaus dürfen leistungsfähige Projekte und Konsortien außerhalb bestehender Clusterstrukturen nicht benachteiligt werden. Förderentscheidungen müssen sich an Exzellenz, Wettbewerbsfähigkeit und dem Beitrag zur europäischen Wertschöpfung orientieren und sollten daher nach Einzelfallprüfung und sorgfältiger Abschätzung mit definierten Kriterien erfolgen.

Außerdem sollten die in Artikel 27 vorgesehenen **European Semiconductor Region Investment Plans** gezielt auf bestehenden regionalen und nationalen Förderinstrumenten aufbauen. Eine enge Verzahnung mit bereits bestehenden Unterstützungsmaßnahmen erhöht die Planungssicherheit für Investoren, vermeidet Fragmentierung und stärkt die Wirksamkeit der öffentlichen Förderung. Um die bestehende Kostenlücke zu führenden internationalen Produktionsstandorten zu verringern und gleichzeitig die Attraktivität Europas als Investitionsstandort zu erhöhen, sollte der Chips Act 2.0 auch koordinierte steuerliche Anreize und Unterstützungsmaßnahmen für Investitions-, Betriebs- und Energiekosten setzen.

Section 4: Resilience in Supply Chains

Öffentliche Beschaffung und Maßnahmen für besonders risikobehaftete Sektoren können einen wichtigen Beitrag zur Stärkung resilienter Halbleiterlieferketten leisten. Öffentliche Auftraggeber können als Ankerkunden Nachfrageimpulse setzen und europäischen Halbleiterunternehmen helfen, neue Technologien in den Markt zu bringen und privates Investitionskapital zu mobilisieren. Gemeinsam mit Verbündeten und Partnern sollte die EU zudem einen robusten Rahmen für vertrauenswürdige Chiplieferanten entwickeln und diesen in strategischen Anwendungen durch Beschaffung und langfristige Nachfragezusagen unterstützen. Vergabe- und Beschaffungsinstrumente sollten jedoch technologie-neutral, skalierungsfähig und offen für EU-ansässige sowie gleichgestellte partnerlandbasierte Anbieter ausgestaltet werden. Die Möglichkeit, in kritischen Sektoren eine **security of supply declaration** zu verlangen, kann grundsätzlich sinnvoll sein, sofern sie verhältnismäßig, transparent und administrativ schlank ausgestaltet wird und nicht zu faktischen Local-Content-Anforderungen, Herkunftsvorgaben oder Einschränkungen globaler Lieferketten führen. Positiv ist, dass Anforderungen mit dem Auftragsgegenstand verbunden sein müssen, in den Ausschreibungsunterlagen klar benannt werden sollen und nicht allein entscheidend für den Zuschlag sein dürfen. Gleichzeitig besteht die Gefahr von zusätzlicher Bürokratie. Nachweispflichten, Risikoanalysen, Stockpiling oder Diversifizierungsaufgaben können für Anwenderindustrien und KMUs erhebliche operative und monetäre Belastungen verursachen.

Bei den **risk-prone sectors** sollte der Fokus zunächst auf Kooperation, freiwilliger Risikovorsorge, Transparenz, positiven Anreizen und besseren europäischen Angeboten liegen. Zudem sollte der Chips Act 2.0 primär auf Zusammenarbeit zwischen Endmarktindustrien, Grand Challenges, ESTIs, Strategic Projects und positive Anreize setzen. Verpflichtende Maßnahmen für Endmarktindustrien sollten nur in Extremfällen verhängt werden. Zudem sollte Public Procurement nicht zu kleinteiligen Nischenlösungen für öffentliche Auftraggeber führen. Beschaffte Produkte sollten skalierbar sein und Unternehmen sollten öffentliche Beschaffung als Sprungbrett in breitere kommerzielle Märkte nutzen können.

Chapter IV – Monitoring and crisis response

Section 1: Monitoring

Strategisches Monitoring und Frühwarnindikatoren können dazu beitragen, Abhängigkeiten, Engpässe, technologische Schwächen und kritische Akteure im europäischen Halbleiterökosystem frühzeitig zu erkennen. Eine belastbare Datenbasis ist notwendig, um politische Maßnahmen evidenzbasiert auszurichten und die Resilienz der europäischen Halbleiterwertschöpfungskette zu stärken. Deswegen ist der Ansatz grundsätzlich zu begrüßen. Gleichzeitig muss vermieden werden, dass Monitoring zu neuen Berichtspflichten für Unternehmen führt.

Die Zielsetzung der geplanten **Business-to-Business Semiconductor Supply Chain Platform**, mehr Transparenz und Krisenreaktionsfähigkeit zu schaffen, ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings bestehen noch erhebliche organisatorische, technische und rechtliche Herausforderungen für eine Implementierung. Zunächst sollte geprüft werden, ob bereits bestehende Mapping- und Monitoring-Aktivitäten ausreichen, bevor zusätzliche Dateninfrastrukturen aufgebaut werden. Die Plattform sollte nur strukturierte Risiken und kritische Produktionsstandorte sichtbar machen und nicht zur Offenlegung wettbewerbskritischer Informationen, Kundenbeziehungen, Absatzmengen, Liefervereinbarungen oder kommerzieller Geschäftsbeziehungen führen. Falls eine Plattform geschaffen wird, sollte sie für EU-ansässige Produktionsstandorte und gleichgestellte Partnerlandunternehmen unter Sicherheits- und Vertraulichkeitsauflagen offenstehen und langfristig finanzierbar sein.

Section 2: Alerts and activation of the crisis stage

Angesichts geopolitischer Spannungen, Exportkontrollen sowie daraus resultierender Rohstoffrisiken und Lieferkettenstörungen ist eine besser koordinierte europäische Krisenprävention im Halbleiterbereich notwendig. Die vorgesehenen Maßgaben für die Aktivierung einer Krisensituation sind daher grundsätzlich sinnvoll. Wichtig ist jedoch, dass sie an hohe Voraussetzungen geknüpft bleiben und das European Semiconductor Board sowie die Industrie eng eingebunden wird. Nur so lassen sich zusätzliche Belastungen für Unternehmen begrenzen und zugleich eine handlungsfähige europäische Krisenreaktion sicherstellen. Da in der Bewertung von Krisensituationen sensible Unternehmensinformationen betroffen sind, sollten Informationsanfragen nur bei konkreten, belegbaren Risiken erfolgen und auf das Notwendige begrenzt werden, da präventive Informationsabfragen sonst zu einem Einfallstor für unverhältnismäßige Datenerhebungen werden.

Section 3: Shortage response

Bei den in Section 3 betrachteten **Priority-rated Orders** und gemeinsamen Beschaffungen durch die Kommission verhält es sich ähnlich. Im Krisenfall sind koordinierte europäische Maßnahmen notwendig, um kritische Sektoren zu stabilisieren. Gleichzeitig greifen Priority-rated Orders tief in Produktionsplanung, Lieferverträge, Kundenbeziehungen und unternehmerische Entscheidungsfreiheit ein. Deswegen sollten sie ausschließlich für klar definierte Krisensituationen vorgesehen bleiben. Eine enge Eingrenzung der Anwendungsfälle sowie wirksame Schutzmechanismen sind erforderlich, um negative Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen, Kundenbeziehungen und internationale Lieferketten zu begrenzen.

Auch krisenbezogene Informationspflichten nach Artikel 41 bleiben sensibel. Informationen über Produktionskapazitäten, Fertigungsfähigkeiten, Auslastungen und aktuelle Störungen betreffen hochvertrauliche Unternehmensdaten. Schutz von Geschäftsgeheimnissen, IP-Rechten, Vertraulichkeit und Wettbewerbsfähigkeit muss daher auch in der Krise gewährleistet bleiben.

Gemeinsame Beschaffung darf nicht zu Marktverzerrungen, Preisverwerfungen oder zur Verdrängung privater Beschaffungskanäle führen. Langfristige Resilienz entsteht primär durch Wettbewerbsfähigkeit, Diversifizierung, Innovation und attraktive Investitionsbedingungen. Der Chips Act 2.0 sollte daher Kriseninstrumente so ausgestalten, dass sie Versorgungssicherheit stärken, ohne dauerhaft in marktwirtschaftliche Prozesse und unternehmerische Entscheidungen einzugreifen.

Chapter V – Governance

Section 1: European Semiconductor Board

Eine bessere Koordinierung zwischen Kommission und Mitgliedstaaten durch die Erweiterung der Kompetenzen des **European Semiconductor Board (ESB)** ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings fehlt die systematische Einbindung der Anwenderbedarfe durch eine verankerte Industriebeteiligung. Nach Artikel 45 können Anwenderindustrien, Gewerkschaften oder andere Stakeholder lediglich „where appropriate“ als Beobachter eingeladen werden. Dies ist unzureichend: Die Industrial Alliance sollte deshalb über ihr Steering Committee ständiges Mitglied des European Semiconductor Board mit Stimmrechten werden. Wenn industrielle Skalierung, Investitionsentscheidungen, Projektpriorisierung und tragfähige Geschäftsmodelle im Zentrum stehen sollen, muss die Industrie zwingend strukturell, transparent und frühzeitig eingebunden werden.

Dass Artikel 47 das Schließen und die Pflege von strategischen Partnerschaften zum Aufgabenprofil des ESB hinzufügt, ist hingegen zu begrüßen. Resilienz und Souveränität entstehen nicht durch Abschottung, sondern durch Kooperationen mit langfristig vertrauenswürdigen Partnern. Auch hier sollte die Industrie gezielt eingebunden werden, da diese direkt durch Kooperationsvorhaben betroffen ist und diese produktiv mitgestalten kann.

Section 2: National competent authorities

Ein **nationaler Single Point of Contact** ist grundsätzlich sinnvoll, da Unternehmen klare Ansprechpartner und harmonisierte Verfahren benötigen. Gerade bei grenzüberschreitenden Projekten, ESTIs, Strategic Projects, Genehmigungsverfahren, Monitoring und Krisenreaktion kann eine eindeutige nationale Koordinierungsstelle helfen, Verfahren zu beschleunigen und Doppelstrukturen zu vermeiden. Bei der konkreten Ausgestaltung ist es wichtig, dass die Kontaktstellen einen industriepolitischen Schwerpunkt haben und nicht rein forschungspolitisch getrieben sind sowie echte Koordinierungs- und Lotsenfunktionen übernehmen, anstatt zu einer zusätzlichen Verwaltungsebene zu werden.

Section 3: Industrial Alliance for Semiconductors

Gerade für Demand Accelerators, Demand Forum, Grand Challenges, Strategic Projects und industrielle Roadmaps ist eine **starke Industrieplattform** zwingend notwendig. Sie kann dafür sorgen, dass die Industrie systematisch entlang der gesamten Wertschöpfungskette strukturell eingebunden wird. Die enge Anbindung an das ESB ist für einen besseren Dialog zwischen Industrie und Politik zu begrüßen.

Die Ausgestaltung in Artikel 49 ist allerdings nicht ausreichend auf Industriebedarfe ausgerichtet. Dass die Kommission den Vorsitz der Alliance übernimmt und Mitglieder ernennen darf, ist kritisch zu bewerten. Eine selbstgesteuerte **Industrial Alliance for Semiconductors mit Industrie-Co-Vorsitz**, klaren Transparenz-, Compliance- und Interessenkonfliktregeln, ausreichenden Ressourcen und echten Mitgestaltungskompetenzen würde die Ausrichtung der Halbleiterpolitik entlang der

Anwenderbedarfe klar stärken. Die Alliance sollte verbindlich in die Priorisierung von Grand Challenges, Demand Accelerators, Strategic Projects, Pilotlinien und Plattform-Governance eingebunden werden.

What's missing?

Um die Investitionsanreize für Unternehmen in Europa zu erhöhen, ist es zwingend notwendig die Rahmenbedingungen zu verbessern, die die Halbleiterbranche belasten. Die aktuellen Rahmenbedingungen der Halbleiterbranche sind komplex und reichen von hohen Energiepreisen, Fachkräftemangel bis hin zu hohen administrativen Aufwänden. Der Chips Act 2.0 kann zwar nicht alle der bestehenden Herausforderungen abschließend lösen, jedoch entscheidende Stellschrauben setzen und als eine Brücke zu weiteren Maßnahmen der Europäischen Union fungieren, die auf eine nachhaltige Stärkung der Branche abzielen.

Die deutsche Industrie hat deshalb im November 2025 **umfassende Forderungen**¹ vorgelegt, die aus unserer Sicht essenziell für den Erfolg des Chips Act 2.0 sind, jedoch im aktuellen Vorschlag der Kommission nicht ausreichend berücksichtigt wurden.

Fachkräftemangel bewältigen

Die **Artikel 5 und 6** des Chips Act 2.0 erwähnen zwar, dass mehr Fachkräfte mobilisiert werden sollen, konkrete Maßnahmen fehlen jedoch. Europa hat einen erheblichen **Mangel an qualifizierten Fachkräften** und durch den geplanten Ausbau des Mikroelektronik-Ökosystems steigt der Bedarf weiter. Deswegen benötigt es gezielte Ausbildungsinitiativen, internationale Anwerbung, monetäre Investitionen in die Ausbildungsinfrastruktur und Programme zur Fachkräftebindung.

Wettbewerbsfähige Energiepreise

Investitionen in die Energieinfrastruktur für eine bessere Versorgung der energieintensiven Halbleiterindustrie sind zwingend notwendig, vor allem Investitionen in die Speicherung und Nutzung erneuerbarer Energien. Diese Investitionen müssen zusammen mit gezielten politischen Maßnahmen dazu beitragen, **wettbewerbsfähige und planbare Energiepreise** zu erreichen. Denn die Attraktivität Europas für Halbleiterinvestitionen hängt nicht nur von Investitionsförderung, sondern auch von langfristig wettbewerbsfähigen Betriebskosten ab. Bezahlbare Energie ist daher eine zentrale Voraussetzung für den Aufbau und Betrieb wirtschaftlich tragfähiger Fertigungskapazitäten. Dies würde nicht nur die Mikroelektronikbranche, sondern auch die gesamte Industrie entlasten und Europa als Investitionsstandort wettbewerbsfähiger machen.

Bürokratie abbauen

Dass die Genehmigungsgeschwindigkeit erhöht werden soll, ist ein positives Signal. Allerdings braucht es konkretere Maßnahmen zur Entbürokratisierung von Verfahren. Förderinstrumente wie der IPCEI on Microelectronics sind grundsätzlich sinnvoll, für Innovationstreiber wie KMU, Start-ups und Scale-ups aufgrund des hohen bürokratischen Aufwands jedoch nur schwer zugänglich. Dadurch bleibt viel Potenzial ungenutzt, das Europa dringend mobilisieren muss. Die Omnibusverfahren der

¹ BDI (2025): Wie gelingt der Chips Act 2.0?, siehe online unter: <https://bdi.eu/de/publications/wie-gelingt-der-chips-act-20> (20.07.2026).

Europäischen Kommission sind ein erster guter Schritt, sollten aber koordinierter auch Genehmigungsverfahren erfassen. Genehmigungen, Förderentscheidungen, Pilotlinien, Strategic Projects und Infrastrukturmaßnahmen sollten verbindlichen Zeitvorgaben unterliegen. Europa muss seine Innovations-, Investitions- und Genehmigungsprozesse deutlich beschleunigen, um mit den weltweit dynamischsten Technologie- und Industriestandorten Schritt zu halten. Forschungsergebnisse müssen schneller in industrielle Anwendungen, wettbewerbsfähige Produktionskapazitäten und marktfähige Produkte überführt werden.

Geschwindigkeit sollte dabei als eigenständiger Wettbewerbsfaktor europäischer Industriepolitik verstanden werden – verbunden mit marktwirtschaftlichen Prinzipien, unternehmerischer Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und langfristiger Investitionssicherheit. Dadurch kann Europa seine Attraktivität als Standort für innovative Halbleiterprojekte nachhaltig stärken.

Realistische Zielsetzungen und messbare Wirkung

Im Gegensatz zum Chips Act 1.0 formuliert der Chips Act 2.0 derzeit keine quantitativen Zielgrößen mehr. Es ist zwar begrüßenswert, dass die Zielmarke von 20 Prozent globalem Marktanteil entfallen ist, da es unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht erreichbar ist. Dennoch können Zielgrößen als strategischer Referenzpunkt dienen, sofern es mit realistischen Zwischenzielen und konkreten Maßzahlen unterlegt werden. Solche Zielgrößen sollten sich an industriellen Bedarfen und Marktgegebenheiten orientieren und in enger Abstimmung mit der Industrie entwickelt werden.

Rechtssicherheit bei Eligibility und Gleichstellung

Der Vorschlag enthält bislang keine belastbare operative Regelung für die Gleichstellung vertrauenswürdiger Partnerlandunternehmen mit Domestic Undertakings. Diese Lücke kann zu einem harten Ausschluss europäischer Produktionsstandorte führen, obwohl diese in Europa investieren, Arbeitsplätze schaffen, Versorgungssicherheit erhöhen und sicherheitsrelevante Zusagen geben können. Der Chips Act 2.0 sollte daher eine ausdrückliche Equivalence-Regelung mit Kriterien, Verfahren und Safeguards enthalten.

Wettbewerbsfähigkeit der Anwenderindustrien als KPI

Der Erfolg des Chips Act 2.0 sollte nicht ausschließlich anhand von Produktionskapazitäten, Marktanteilen oder Fördervolumina bewertet werden. Ebenso entscheidend ist die Wirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Anwenderindustrien. Die Resilienz, Innovationsfähigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit von Branchen wie der Automobil-, Maschinenbau-, Energie- und Telekommunikationsindustrie sollten deshalb als zentrale Erfolgsindikatoren des europäischen Halbleiterökosystems berücksichtigt werden.

Portierung bestehender Chipdesigns nach Europa fördern

Der Chips Act 2.0 adressiert Abhängigkeiten von Drittstaaten sowohl beim Chipdesign als auch bei der Fertigung und führt neue nachfrage- und designseitige Instrumente ein. Eine der schnellsten und wirksamsten Maßnahmen fehlt jedoch bislang: die Förderung der Portierung bestehender Chipdesigns aus Drittstaaten in europäische Fabriken. Ohne ein solches Instrument besteht das Risiko, dass mit erheblichen öffentlichen Mitteln aufgebaute Kapazitäten unterausgelastet bleiben. Die Portierung verursacht erhebliche Einmalkosten von etwa 2 bis 20 Millionen Euro pro Design, da Produkte für jede neue Foundry technisch angepasst und qualifiziert werden müssen. Für Unternehmen stellen diese Kosten ein zusätzliches Risiko dar, während der Nutzen einer resilienteren und sichereren Lieferkette

vor allem der EU zugutekommt. Deshalb fordert die deutsche Industrie, die Portierung strategisch relevanter Designs als förderfähige Kostenkategorie anzuerkennen und im Rahmen der Chips for Europe Initiative 2.0 finanziell zu unterstützen. So könnten europäische Fabriken nicht nur gebaut, sondern auch mit konkreten Aufträgen ausgelastet werden und wirksam zur Versorgungssicherheit beitragen.

Impressum

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
Breite Straße 29, 10178 Berlin
www.bdi.eu
T: +49 30 2028-0

EU-Transparenzregister: 1771817758-48

Lobbyregister: R000534

Redaktion

Lukas Martin
Senior Representative Innovation, Sicherheit und Technologie
T: +32 27921017
l.martin@bdi.eu

Marten Kwast
Studentischer Mitarbeiter Innovation, Sicherheit und Technologie
T: +49 30 2028-1522
m.kwast@bdi.eu

BDI Dokumentennummer: D2373